(001)GaAs 基板上の GaAs_{1-x}Bi_x 薄膜の構造評価(2) 固相成長した GaAs_{1-x}Bi_x 薄膜中の欠陥の TEM 評価

Structural evaluation of GaAs_{1-x}Bi_x thin film on (001)GaAs substrate (2) TEM evaluation of defects in GaAs_{1-x}Bi_x thin film obtained by solid-phase epitaxy 明治大¹,金沢工大²,広島大³,愛媛大⁴,北海道大⁵○上田 修¹,池永 訓昭²,堀田 行紘³,高垣 佑斗³,西山 文隆³,行宗 詳規⁴,石川史太郎⁵,富永 依里子³ Meiji Univ.¹, Kanazawa Inst. Tech.², Hiroshima Univ.³, Ehime Univ.⁴, Hokkaido Univ.⁵ O. Ueda¹, N. Ikenaga², Y. Horita³, Y. Takagaki³, F. Nishiyama², M. Yukimune⁴, F. Ishikawa⁵, Y. Tominaga³ E-mail: nanotec4@meiji.ac.jp

【はじめに】我々は、前講演で熱処理した低温成長(LTG)GaAs_{1-x}Bi_x薄膜中に、As 析出物、Bi-rich GaAs_{1-x}Bi_x析出物、およびBi 析出物が形成されることや各々の析出物の挙動がBi 組成、成長条件、および熱処理条件により影響を受けることなどについて明らかにした [1-3]。一方、非晶質薄膜を用いた固相成長(solid-phase epitaxy: SPE)では、不純物、点欠陥、および欠陥クラスタ(析出物を含む)などの均一な分布を実現できると期待される。そこで、我々は今回、非晶質 GaAs_{1-x}Bi_x薄膜の固相成長を行い、薄膜中で形成される欠陥を TEM 評価し、既報 [1-3] と比較したので報告する。【実験方法】実験に用いた試料は、(001) GaAs 基板上に 180℃で MBE 装置により作製した非晶質 GaAs_{1-x}Bi_x 薄膜 (x=0.0095)およびそれを 350℃および 600℃で 1 h SPE 処理したものである。また、TEM 用薄膜は FIB 加工により行い、TEM 評価は、分析電顕 JEOL JEM-2100F を用いて行った。

【参考文献】[1] Wu et al., Nanotechnology 25, 205605 (2014); [2] 上田他、本講演会、本講演の前講演; [3] O. Ueda et al., J. Cryst. Growth 601, 126945 (2023).

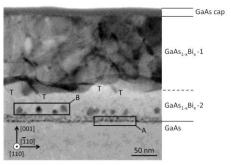


Fig. 1 A (110) cross-sectional STEM image of a thin film after annealing of α -GaAs_{1-x}Bi_x layer for 1 h at 350 °C.

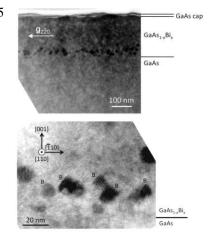


Fig. 2 TEM images of a thin film after annealing of α -GaAs_{1-x}Bi_x layer for 1 h at 600 °C.